

SB-601 型曝光机

主要用于功率电子器件、传感器、光电子器件、微波电路、MEMS（微电子机械系统）以及其它新型电子元器件的单、双面对准及曝光工艺。

主要技术特点：

1. 独特的版架支撑系统，可对基片与掩模之间的接触压力进行调节和显示，实现掩模与基片的精确分离和接触。
2. 底部和顶部对准观察系统扫描范围大，成像清晰、定位精度高。物镜由微电机驱动，可独立进行 X、Y、Z 向三维调节，移动速度线性可调。
3. 由多关节机械手和预对准台实现自动上、下片，提高生产效率。
4. 采用先进的空气轴承设计，可快速、精确地进行楔形误差补偿，结构自由度高，找平效果好。高性能恒功率汞灯电源，易于触发，可靠性高，并具有安全保护功能。



A 型



B、C 型

主要技术指标：

- 基片尺寸： $\phi 6''$
- 掩模尺寸： $7'' \times 7''$
- 双面对准精度： $2.0 \mu m$ ($20\times$ 物镜)
- 放大总倍率： $90\times$ 、 $175\times$ 、 $350\times$
- 对准工作台机构指标：
行程： X/Y: $\pm 5mm$
 θ 向旋转： $\pm 5^\circ$ (C 型)；
 $\pm 3^\circ$ (A、B 型)
- Z 向驱动机构指标：
Z 向驱动行程： $10mm$
- 曝光光源机构指标：
曝光分辨率： $1.5 \mu m$ (真空接触)
最大曝光范围： $\phi 160mm$, UV400
曝光不均匀性： $\pm 5\%$ ($\phi 160mm$)； $\pm 3\%$ ($\phi 110mm$)
曝光强度： $\geq 10mW/cm^2$ (1000W 汞灯)
- 物镜分离距离：
 $30\sim 100mm$ (BSA) (B、C 型)
 $60\sim 100mm$ (BSA) (A 型)
 $30\sim 145mm$ (TSA)
- 预对准台精度：



±60 μm (可选, 仅适用于 φ4"、φ6" 基片)

所需设施:

输入电压: ~220V ± 22 V(50Hz)

整机功率: 1.5KW

室内光线: 红色、黄色

压缩空气: 0.5~0.7MPa

氮气: 0.2~0.4MPa

真空: -0.08~-0.1MPa

体积及重量:

外形尺寸:

1500mm×1100mm×1860mm (A 型)

940mm×1100mm×1860mm (B、C 型)

重量: 500kg (A 型)

400kg (B、C 型)